



NC257-2 Paste Flux

Paste Flux

Features:

- Ottima bagnabilità
- Ampia finestra di processo
- Compatibile lead free e Pb
- Utilizzata per Ball Attach

Description:

NC257-2 Paste Flux è un gel adesivo ideale per il rework e per bagnare praticamente tutte le finiture dei circuiti, dei componenti e dei substrati. NC 257-2 Paste Flux può essere utilizzata per il rework dei circuiti stampati o per le sfere dei BGA. La capacità di attivazione della Paste Flux NC 257-2 comporta l'ottenimento di giunti affidabili, lisci e brillanti, sia che la rifusione avvenga a mano, sia con l'utilizzo di stazioni di rework ad aria, forni di rifusione o sistemi di saldatura vapor phase. I residui sulle superfici sono chiari ed esteticamente apprezzabili e possono essere facilmente testabili con letto d'aghi. NC 257-2 Paste Flux è idonea per l'utilizzo sia con le leghe Sn/Pb che con tutte le leghe lead free ed è impiegabile in una vasta gamma di applicazioni. Può essere applicata a pennello, a spazzola, dispensata o serigrafata. E' disponibile in siringhe da 10 e da 30 cc.

Applicazione del flussante:

Per il rework, l'impiego deve essere limitato all'area di riparazione. Si raccomanda l'utilizzo con ago dispensatore o spazzola-pennellino

Cleaning:

- NC257-2 Paste Flux può essere lavato, se richiesto, con acqua saponificata o con i solventi presenti sul mercato.
- Controllare la matrice di compatibilità con i maggiori solventi sul mercato, se necessario.

Manipolazione e stoccaggio:

- NC257-2 Paste Flux ha una scadenza di un anno se refrigerata 4°- 12°C , e 6 mesi a temperatura ambiente
- Prima dell'utilizzo lasciare che il gel si stabilizzi a temperatura ambiente (2 ore) .
- Non mischiare gel fresco e gel usato nello stesso contenitore

Sicurezza:

- Usare con adeguata ventilazione e con appropriati dispositivi di protezione individuale.
- Riferirsi alla Scheda di sicurezza a corredo per informazioni specifiche d'emergenza.
- Non smaltire il prodotto in contenitori non appropriati.

Proprietà fisiche:

Parametro	Valore
J-STD-004B	REL1
Numero Acido	150.02mg KOH per gram flux

Parametro	Valore
Viscosità	consistenza gelatinosa
Residui	Chiari, Incolori

Test di corrosione:

Parametro	Requisiti	Resultati
Copper Mirror (24 hrs @ 25°C, 50%RH)	IPC-TM-650-2.3.32	Basso
Halide Test (Silver Chromate)	IPC-TM-650-2.2.33	Passa

SIR:

Reference	Property	Pass-Fail Criteria	Results
IPC-TM-650 method 2.6.3.3 85°C / 85% R.H.	Control coupons	>1E+9 Ω at 96 and 168 hrs	Pass
	Sample coupons – pattern up	>1E+8 Ω at 96 and 168 hrs	Pass
	Sample coupons – pattern down	>1E+8 Ω at 96 and 168 hrs	Pass
	Post-test visual inspection	No dendrite growth or corrosion	Pass

Canada +1-514-494-2000 · USA +1-401-463-5605 · Mexico +52-656-630-0032 · Europe +44-1737-222-258
Asia-Pacific +86-755-2993-6487 · India +91-80-41554753 · info@aimsolder.com · www.aimsolder.com
AIM IS ISO9001:2008 & ISO14001:2004 CERTIFIED

The information contained herein is based on data considered accurate and is offered at no charge. Product information is based upon the assumption of proper handling and operating conditions. All information pertaining to solder paste is produced with 45-micron powder. Liability is expressly disclaimed for any loss or injury arising out of the use of this information or the use of any materials designated. Please refer to <http://www.aimsolder.com/Home/TermsConditions.aspx> to review AIM's terms and conditions.

05/15
Document Rev # 10